



12 MAY, 2022

Azmin : Malaysia expected to garner RM14.6 billion in new investments from US

Kwong Wah Yit Poh, Malaysia

Page 1 of 1

阿兹敏访美招商引资 料获逾146亿新投资

（华盛顿 11 日讯）随着国际贸易及工业部长拿督斯里阿兹敏率领贸易与投资代表团到美国招商引资，预计我国可从美国获得 146 亿 2000 万令吉新投资。

阿兹敏指出，在这次访问期间，许多美国公司表达会扩大在马来西亚的业务及版图。“我们将在未来几天有一些重大宣布，即这些公司所承诺的新投资总额。”

阿兹敏周二在美国接受马新社及TV3电视记者访问时，这么说。阿兹敏是于5月8日起到美国进行为期10天的贸易投资访问。

至今，阿兹敏已会见数间高科技公司如全球半导体公司德州仪器公司及电子组装材料与半导体装配公司 Indium Corporation，而他将在访问旧金山、西雅图和洛杉矶时会见更多高科技业者。

他说，贸工部将继续贸易访问吸引更多投资，因为高素质的投资将为马来西亚人才创造更多就业机会。



阿兹敏。

冀针对启动TIFA达结论

阿兹敏指出，美国贸易代表戴琪欢迎马来西亚提出恢复“贸易与投资框架协议”（TIFA）建议，他希望两国能在近期针对启动该协议达致结论。

他与戴琪举行双边会议后说，我国原则上是愿意与美国针对此事进一步讨论，因为两国最后一次讨论 TIFA 是在 2005 年，之后没有任何进展，尽管双方在 2017 年曾试图重新检视和恢复。

“当然，我们需要看 TIFA 如何适应和缓和我们现在面临的全球挑战，如供应链弹性。”

针对他与美国商务部长吉娜雷蒙多会面时提及印度太平洋经济框架（IPEF），阿兹敏说，我国愿针对此事展开更多讨论，并确保东盟中心精神得到尊重，以及所有东盟成员都彻底讨论此事。

阿兹敏与吉娜雷蒙多在双边会议后，签署确保供应链弹性的合作备忘录。

他说，戴琪及吉娜雷蒙多已同意加强美国与马来西亚之间的对话和磋商，解决劳动力管治方式课题，以符合环境、社会和治理（ESG）框架和国际标准，而这肯定能让我国公司在全球市场竞争中受惠及有优势。

阿兹敏也与吉娜雷蒙多联合主持圆桌会议，与美国主要半导体业者对话，尽管汽车、宇航及医疗设备领域对半导体的需求飙升，但两位领袖都确保供应链弹性。

“这些公司也向我保障，他们将继续在马来西亚中小企业及本地供应商的参与下，协助发展生态系统。” #